



# 「鈮酸鈉鉀-鈦酸铋鈉鉀壓電陶瓷系統」掺雜五氧化二鈮其

# 物理及電特性之影響

王俊惠<sup>1,2</sup> 林書賢<sup>1</sup>

南榮技術學院工程科技研究所1南榮技術學院電子工程系2

#### 摘要

本論文提出最新無鉛壓電陶瓷系統『0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03 Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.90</sub>K<sub>0.10</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>』掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 藉由不同的掺雜比例,研究無鉛壓電陶瓷相對較佳的壓電及介電特性。由 XRD 圖發現主系統晶格結構 為斜方晶相,掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(0 wt%、0.1 wt%、0.2 wt%、0.3 wt%、0.4 wt%)並無影響到系統的晶相結構。在 主系統掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 重量百分比達 0.2 wt%,由 SEM 觀察其孔隙較小、緻密度較高;因為屬於軟掺雜效 應,所以有效提高機電耦合因素及介電常數值,平面機電耦合因素可達約 0.41,厚度機電耦合因素可達 約 0.55,並且有較高的介電常數值約 1289。

**關鍵詞**: 鈮酸鈉鉀、鈦酸鉍鈉鉀、燒結、壓電性質、介電性質

#### 一、緣由與目的

錯鈦酸鉛 Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> (PZT) 是壓電最為重要的材料,但是材料組成中含鉛成分, 製造過程中將對環境造成污染。為了解決這個問題,不含鉛的壓電電陶瓷是未來研究的 重點。

許多科學家已針對壓電陶瓷無鉛替代材料這個問題,目前研究出以鈮酸鈉鉀 (Na<sub>1-x</sub>K<sub>x</sub>)NbO<sub>3</sub> [NKN])為主的固溶系統,此系統有較佳的壓電性質。但是鈮酸鈉鉀陶瓷 製程中採用熱壓燒結等,這些特殊技術不利於工廠大量製造。鈮酸鈉鉀陶瓷若是在一般 空氣中燒結,由於相穩定度受限於 1140°C 所以不能在較高溫度燒結,導致於陶瓷體密 度較低相對的特性就較差,所以此類材料有不易合成、不易燒結緻密、潮解及導電等問 題。文獻[1-5]發現鈮酸鈉鉀(Na<sub>1-x</sub>K<sub>x</sub>)NbO<sub>3</sub> [NKN]),若添加屬於鈣鈦礦 ABO<sub>3</sub> 結構的化 合物在一般空氣中燒結就可得到緻密性陶瓷,但電特性仍需改善。目前一些科學家已針 對鈮酸鈉鉀(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub> 系統添加其他鈣鈦礦來改善其緻密性及電特性質[5],本研 究採用 0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub> 當作無鉛壓電陶瓷系統研發重 點,摻雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 至系統中變化 0~0.4 wt.%成分來探討其介電及壓電特性。

### 二、實驗方法與量測

以固相反應進行製作,起始原料為Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、TiO<sub>2</sub>,然後根 據化學公式 0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub> - 0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub> K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>進行調配。將配好粉末和酒 精放入氧化鋯球球磨均匀混合12小時後,經過烘乾再放入氧化鋁坩堝高溫煆燒,煆燒條 件為950 ℃持溫4小時,接著將這些磨碎後的粉末摻雜Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>摻雜比例為0 wt% ~ 0.4 wt



%。球磨均勻混合12 小時後,經過烘乾添加黏劑並經100 mesh 過篩後,在700 kg/cm<sup>2</sup> 壓 力進行壓模,最後可得直徑15 mm厚度約為1.0 mm的圓板狀的陶瓷胚片,燒結條件固定 1100℃,持溫時間3小時。把燒結後的陶瓷片經磨平和拋光,然後在陶瓷片兩面塗上銀 膠電極,經500℃熱處理後,接著做極化處理,然後在將陶瓷片放入水中冷卻靜置24小 時後,讓內部電偶極穩定方可測量其電特性。極化條件如下:固定時間為30分鐘、溫度 為120~200 ℃、電場強度為3~4 kV/mm。在做介電及壓電測量時,使用HP4192低頻阻抗 分析儀,並根據參考文獻IREStandard [6],在1 kHZ 時其電容損失、介電常數,另外震 盪頻率、反震盪頻率、共振電阻將被測量,以便計算一些重要參數(kp、kt、Qm)。另外 藉由掃描式電子顯微鏡(SEM)來觀察陶瓷表面微結構晶粒大小[7]。

### 三、結果與討論

圖1 顯示 0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (0 ~ 0.4 wt%) 在 1100℃/5小時之XRD(X-ray diffraction)圖。觀察系統46°~48°仍為斜方晶相,也就是說系 統在Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>掺雜後並不影響其結構。

圖2 顯示0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub> 掺雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 成份(0 wt%~0.4 wt%)之SEM照片。系統未掺雜時晶粒較小且孔洞較多、緻密度較低,當掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>0.2wt% 時可得到較高的密度,因晶粒成長且孔洞較少緻密度較高,而掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 超過0.2 wt%時,隨著掺雜百分比越高時,因晶粒反而變小,且密度降低,這可能是因 為過份掺雜所造成的結果。

圖 3 顯示 0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03 Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub> 掺雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>成份(0 wt%~0.4 wt%)對測量密度之曲線圖。當未摻雜時其密度較低,當摻雜Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0.2 wt%其 緻密度較高,摻雜比例越高時,因晶粒成長較小,密度開始降低。

將平面機電耦合因數(k<sub>p</sub>)及厚度機電耦合因數(k<sub>t</sub>)之量測結果[6],利用阻抗分析儀來 量測其振盪頻率(f<sub>r</sub>)和反振盪頻率(f<sub>a</sub>)得到之值帶入公式(1)即可得到平面機電耦合因素 及平面機電厚度因素值,公式(1)如下:

$$\frac{1}{k_p^2} = 0.395 \frac{f_r}{f_a - f_r} + 0.574$$
$$\frac{1}{k_t^2} = 0.81 \frac{f_r}{f_a - f_r} + 0.405 \tag{1}$$

圖 4 顯示  $0.97(Na_{0.5}K_{0.5})NbO_3-0.03$   $Bi_{0.5}(Na_{0.9}K_{0.1})_{0.5}TiO_3$  掺雜不同  $Nb_2O_5$  成份(0 wt%~0.4 wt%)對  $k_p$ 之曲線圖。當摻雜  $Nb_2O_5 0.2$  wt% 其  $k_p$  值比較高,而摻雜百分比越高時,  $k_p$  值開始降低,

圖 5 顯示  $0.97(Na_{0.5}K_{0.5})NbO_3-0.03$   $Bi_{0.5}(Na_{0.9}K_{0.1})_{0.5}TiO_3$  掺雜不同  $Nb_2O_5$  成份 (0wt%~0.4wt%)對  $k_t$ 之曲線圖。當摻雜 0.2 wt%  $Nb_2O_5$ 時比起其他較高摻雜,有較高之  $k_t$ 值,當摻雜  $Nb_2O_5$ 越高時, $k_t$ 值越低。







圖 6 顯示掺雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>成份(0 wt%~0.4 wt%)對介電常數曲線圖。當未掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 其介電常數值明顯的偏低,當摻雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>0.2 wt% 其介電常數值較高而摻雜百分比越高 時,因晶粒成長較小,介電常數值開始降低,對照密度值有同樣情形。

圖 7 顯示 0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub> 掺雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 成份(0 wt%~0.4 wt%)對械品質因素和損失曲線圖。由圖中可看出不掺雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>時,機械品質因素較高,損失較低,而 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 掺雜比例增加時,機械品質因素隨之降低,介電損失也隨 之升高,這是因軟性掺雜造成晶域容易轉動,使得機械品質因數降低,介電損失增加。

### 四、結論

0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub> [0.97NKN-0.03BNKT] 系 統 摻 雜 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (0~ 0.4 wt%) 在1100℃/5小時並找出適當的壓電及介電性質可得到以下結論:

(1) 由 SEM 圖發現 0.97NKN-0.03BNKT 系統摻雜 0.2 wt% Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 時,孔隙較小緻密度 較高,並有較高的介電常數值約 1289。

- (2) 0.97NKN-0.03BNKT 系統 接雜 0.2 wt% Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>時有最高的 kp 值約 0.41、kt 值約 0.55。
- (3) 0.97NKN-0.03BNKT 系統摻雜 Nb2O5,機械品質因素隨之降低,介電損失也隨之升
- 高,這是因軟性摻雜造成晶域容易轉動。

#### 誌 謝

本論文感謝國科會專題計劃(NSC100-2221-E-232-002)經費支助,在此表示感謝之意。

## 参考文獻

- [1] B.Jaffe et.al., (1971), "Piezoelectric Ceramics", p.50.
- [2] Tadashi Takenaka, Hajime Nagata, Yuji Hiruma, (2008), Current Developments and prospective of lead-free piezoelectric ceramics, Japan Society of Applied Physics 47[5], 3787-380.
- [3] Zhiwu Chen, Jianqiang Hu, Xinhua He, (2008), Piezoelectric and dielectric properties.
- [4] Takenaka, T., Sakata, K. and Toda, K., (1990), Piezoelectric properties of (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>) TiO<sub>3</sub>-based ceramics. Ferroelectrics, **106**, 375–380.
- [5] Takenaka, T., Okuda, T. and Takegahara, K., (1997), Lead-free piezoelectric ceramics based on (BiNa)<sub>1/2</sub>TiO<sub>3</sub>–NaNbO<sub>3</sub>, Ferroelectrics, **196**, 175–178.
- [6] Anon., (1961), IRE Standards on Piezoelectric Crystals: Measurement of Piezoelectric Ceramics, Proc.IRE., **49**, 1161-1168.
- [7] Senda, T., and Bradt, R.C., (1990), Grain growth in sintered ZnO and ZnO-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramics, J.Am.Ceram.Soc., **73**(1), 106-114.





圖 1:0.97(Na\_{0.5}K\_{0.5})NbO\_3-0.03Bi\_{0.5}(Na\_{0.9}K\_{0.1})\_{0.5}TiO\_3 系統摻雜不同 Nb\_2O\_5 成分的 XRD 圖。



(a) 0 wt%







(c) 0.2 wt%



(d) 0.3 wt%







(e) 0.4 wt%





圖3:0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>系統摻雜不同Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>之密度曲線圖。





圖4:0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>系統摻雜不同Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 之平面機電耦合因素曲線圖。



圖 5:0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>系統雜摻雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 之厚度機電 耦合因素曲線圖。





圖 6:0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>系統摻雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>之介電常數曲線 圖。



圖 7:0.97(Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub>-0.03Bi<sub>0.5</sub>(Na<sub>0.9</sub>K<sub>0.1</sub>)<sub>0.5</sub>TiO<sub>3</sub>系統摻雜不同 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 之機械品質因 素及介電損失曲線圖。

